

株式会社ニコンのウエハー接合技術に関する研究開発事業を譲受

株式会社SCREENホールディングスは、株式会社ニコン（以下、ニコン社 本社：東京都品川区、代表者：代表取締役 兼 会長執行役員 馬立 稔和）のウエハー接合技術に関する研究開発事業（以下、当該事業）を、9月30日付で譲受したことをお知らせします。

半導体アドバンスド（先端）パッケージ分野では、省スペース、省電力への需要の高まりを受け、ウエハー接合（貼り合わせ）のさらなる高精度化が求められています。当社ではアドバンスドパッケージ分野を注力領域と位置付け、直接描画装置や塗布乾燥装置の販売に加えて、ウエハーの低温接合技術の開発および実装化を進めています。当該事業譲受により、ニコン社の超高精度接合技術やノウハウと当社の既存技術を融合し、世界最高水準の接合技術を目指すとともに、当該分野でのプレゼンス確立を図ります。

当社は現在、中期経営計画「Value Up Further 2026（3カ年）」の下、成長投資を重点的に行っています。特にアドバンスドパッケージ事業は新規事業領域として成長が期待されることから、今回の譲受に至りました。本譲受に伴う影響は計画に織り込み済みであり、当期の業績予想に変更はありません。

当社は、今後も半導体パッケージ市場のさまざまなニーズに応え、同業界の発展に貢献していきます。

事業譲受の概要

- | | |
|-------------|---|
| (1) 譲受事業の内容 | 株式会社ニコンのウエハー接合技術に関する研究開発事業 |
| (2) 譲渡会社 | 会社名：株式会社ニコン
所在地：東京都品川区西大井1-5-20
代表者：代表取締役 兼 会長執行役員 馬立 稔和
資本金：654億7,600万円（2025年3月期）
設立年月日：1917年7月25日 |
| (3) 契約締結日 | 2025年8月14日 |
| (4) 事業譲受日 | 2025年9月30日 |

本件についてのお問い合わせ先

株式会社SCREENホールディングス

経営戦略本部 コーポレートコミュニケーション室 広報部 Tel: 075-414-7131 nr-info@screen.co.jp